



FOR IMMEDIATE RELEASE

**EV Group、HBM および 3D DRAM 向けの画期的なウェーハ仮接合と剥離ソリューションを
SEMICON Korea で発表**

*EVG IR LayerRelease™ 剥離技術により TB/DB アプリケーションの可能性を拡大し、
将来のチップ積層ニーズに対応*

オーストリア ザンクト・フローリアン / 韓国 ソウル、2025 年 2 月 18 日— 最先端および将来の半導体設計と半導体集積化スキームに役立つ革新的なプロセスソリューションと専門知識を提供するリーディングプロバイダーである EV Group (以下、EVG) は、2 月 19 日から 21 日に韓国ソウルで開催される SEMICON Korea 2025 にて、業界をリードする IR LayerRelease™ 仮接合および剥離 (TB/DB) ソリューション、そしてその他のウェーハ接合とリソグラフィ技術を紹介することを、本日発表いたしました。

ウェーハ接合技術およびマーケットリーダーとして EVG は、人工知能 (AI) アクセラレータやその他のハイパフォーマンス・コンピューティング (HPC) アプリケーションを支える高帯域幅メモリ (HBM) および 3D スタック DRAM デバイスの開発と製造を推進する TB/DB を含む最も包括的なウェーハ接合ソリューションのポートフォリオを提供しています。AI は、先端パッケージングや持続可能な半導体製造とともに、未来を形作る主要なトレンドを紹介する世界有数の半導体技術展示会の 1 つである SEMICON Korea の重要な焦点領域です。

EV Group のアジア/太平洋地域セールスディレクターであるトーステン・マティアス博士は次のように述べています。「次世代 HBM および 3D スタック DRAM の開発と量産化の加速は、韓国のチップ業界にとって最優先事項であり、仮接合および剥離技術の進歩が求められています。EVG の IR LayerRelease 技術は市場に革命をもたらし、レーザー剥離によって、より高度な HBM スタックの薄型ダイを実現し、機械剥離の代替として、現在および将来の世代のメモリ積層においてシリコン支持基板をサポートします。さらに、フロントエンドの互換性により、フュージョンおよびハイブリッド接合プロセスフローと組み合わせることができ、次世代のメモリやロジックに不可欠な極薄ウェーハとフィルム処理に最適な技術です。」

先端メモリに不可欠なウェーハ仮接合/剥離技術

HBM と 3D DRAM は、高帯域幅、低レイテンシ、低消費電力を小さなフットプリントで実現できるため、AI トレーニング・アプリケーションに対する高まる需要をサポートする有望な半導体技術として登場しました。仮接合と剥離は、これらの先端メモリ・デバイスの製造に必須であるチップ積層の重要なプロセス工程です。機械剥離などの従来の剥離ソリューションでは、将来の HBM 設計のような非常に複雑な形状を特徴とする超薄型ウェーハに必要な精度が十分に出すことができません。EVG の IR LayerRelease ソリューションは、精度、歩留まりの向上、所有コストの削減、環境負荷の軽減、そして将来性という点で、韓国やその他の国のメモリやその他のデバイスメーカーに、明らかなメリットをもたらします。IR LayerRelease は機械剥離に代わるものであり、EVG®850 プラットフォームをベースとした当社のスライド・オフおよび UV レーザー剥離ソリューションとともに、EVG の剥離技術ポートフォリオをさらに強化します。

IR LayerRelease の詳細

EVG の IR LayerRelease 技術は、シリコンを通過する波長帯の赤外 (IR) レーザーの使用を特徴とする、フロントエンドと完全に互換性のあるレイヤー剥離技術です。この技術は、特別に調合された無機層と組み合わせることで、シリコン基板からあらゆる超薄膜や層をナノメートル精度でレーザー剥離し、業界最高の剥離スループットを実現します。その結果、IR LayerRelease は、高度なパッケージング用のガラス基板が不要となり、3D IC や 3次元シーケンシャル実装アプリケーション向けのまったく新しいプロセスフローを実現します。これにより、シリコン支持基板上の極薄層のハイブリッド/フュージョン接合が可能になります。IR LayerRelease は、IR 露光後の洗浄に有機溶剤ではなく無機溶剤を使用するため、工場環境に良いだけでなく、化学的なフットプリントを最小限に抑えます。そして、完全自動型の大量生産プラットフォームである EVG®880 に統合することができます。

EVG at SEMICON Korea

EVG は、2月19日から21日まで韓国ソウルの COEX コンベンション アンド エキシビション センターで開催される SEMICON Korea で、AI、HPC、高度なパッケージング、持続可能な半導体製造の進歩を可能にする同社の革新的なプロセスソリューションを紹介します。EVG ブース C740(ホール C3 階)の EVG にぜひお立ち寄りください。

EV Group (EVG)について

EV Group (EVG) は、最先端、かつ将来の半導体設計と半導体集積化スキームに役立つ革新的なプロセスソリューションと専門知識を提供しています。「革新技術の探求、そして、マイクロ・ナノ加工技術の次世代アプリケーションを提供する先駆者であり続ける」というビジョンのもと、独自の技術を駆使して、お客様の新規製品開発と商品化をサポートしています。ウェーハ接合、リソグラフィ、薄ウェーハ処理、計測機器などの EVG の量産対応製品は、半導体製造前工程におけるスケーリング、3D 集積、先端パッケージング、その他のエレクトロニクスやフォトリソグラフィ・アプリケーションの進歩を可能にします。EVG に関する詳しい情報は <https://www.evgroup.com/ja/> をご参照ください。

お問い合わせ先:

イーヴィグループジャパン株式会社 マーケティング担当
TEL: 045-348-0665
E-mail: Marketing+CommunicationsJapan@EVGroup.com

Contacts:

Clemens Schütte
Director, Marketing and Communications
EV Group
Tel: +43 7712 5311 0
E-mail: Marketing@EVGroup.com

David Moreno
Principal
Open Sky Communications
Tel: +1.415.519.3915
E-mail: dmoreno@openskypr.com

###



プレス写真: オーストリアのグローバル本社にある最先端の HICC ヘテロジニアス・インテグレーション・コンピテンスセンターでの EVG LayerRelease™ プロセスの開発と検証